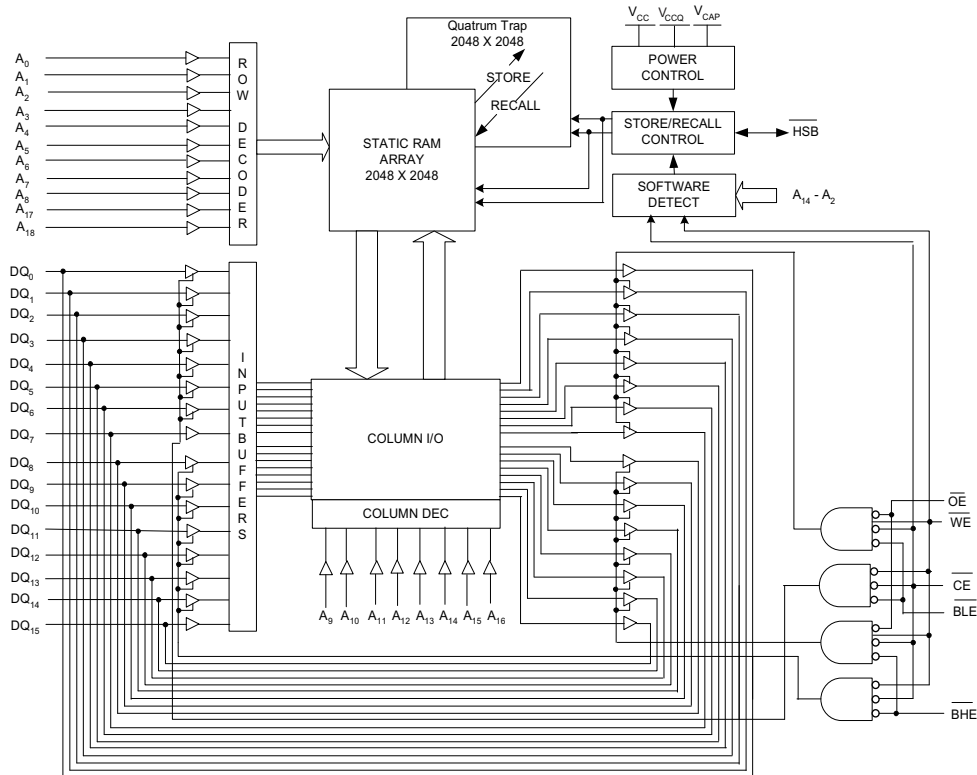


特性

- 访问时间为 25 ns 和 45 ns
- 内部采用 512 K × 8 (CY14V104LA) 或 256 K × 16 (CY14V104NA) 的组织方式
- 只需一个小电容器, 即可在断电时实现自动存储
- 可通过软件、器件引脚或断电时自动存储来触发存储至 QuantumTrap 非易失性元件
- 可通过软件或加电触发回读到 SRAM
- 无限次读、写和回读周期
- 一百万次 QuantumTrap 存储周期
- 20 年的数据保留时间
- 内核 $V_{CC} = 3.0\text{ V} \sim 3.6\text{ V}$; IO $V_{CCQ} = 1.65\text{ V} \sim 1.95\text{ V}$
- 工业级温度
- 48 球形焊盘小间距球栅阵列 (FBGA) 封装
- 无铅并满足有害物质限制 (RoHS) 规定

逻辑框图^[1、2、3]



注释:

1. 地址 A_0 - A_{18} 适用于 × 8 配置; 地址 A_0 - A_{17} 适用于 × 16 配置。
2. 数据 DQ_0 - DQ_7 适用于 × 8 配置; 数据 DQ_0 - DQ_{15} 适用于 × 16 配置。
3. BHE 和 BLE 仅适用于 × 16 配置。

功能说明

赛普拉斯 CY14V104LA/CY14V104NA 是一种快速静态 RAM, 且每个存储器单元中都包含非易失性元件。该存储器采用 512 K byte (每个字节 8 位) 或 256 K 字 (每个字 16 位) 的组织方式。嵌入式非易失性元件通过采用 QuantumTrap 技术, 打造出了世界上最可靠的非易失性存储器。SRAM 能够实现无限次读写周期, 而独立的非易失性数据则存储在高度可靠的 QuantumTrap 单元中。断电时, 数据会从 SRAM 自动转移到非易失性元件中 (“存储”操作)。加电时, 数据会从非易失性存储器回读到 SRAM (“回读”操作)。也可以在软件控制下执行 “存储” 和 “回读” 操作。

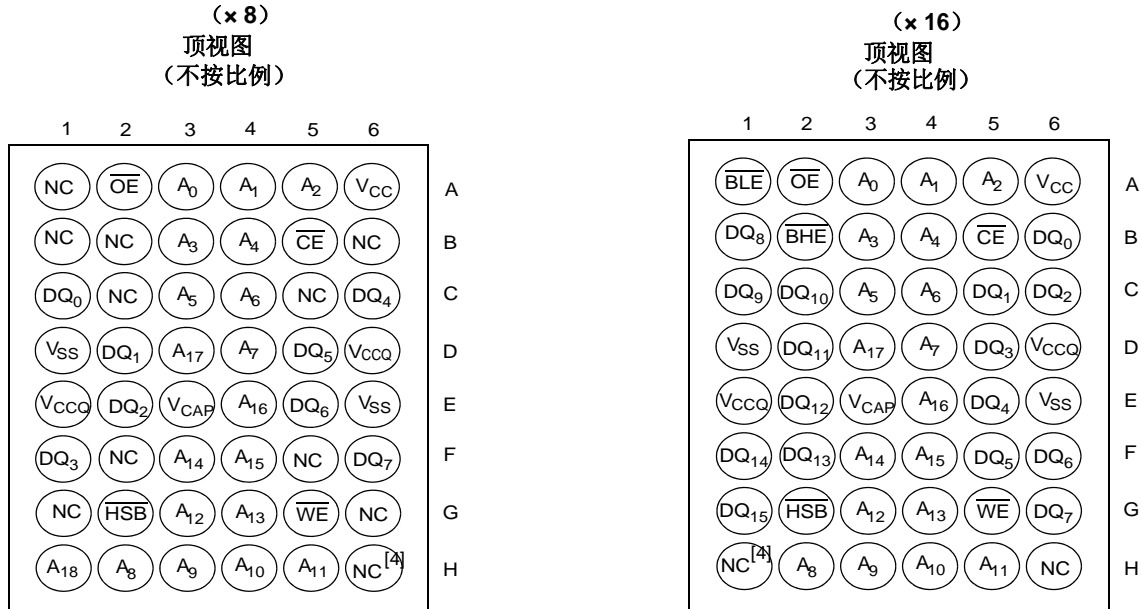
要获取相关文档的完整列表, 请单击[此处](#)。

目录

引脚分布	3	自动存储 / 加电回读	14
引脚定义	3	开关波形	14
器件运行	4	软件控制的存储 / 回读周期	15
SRAM 读取	4	开关波形	15
SRAM 写入	4	硬件存储周期	16
自动存储操作	4	开关波形	16
硬件存储操作	4	SRAM 操作的真值表	17
硬件回读（加电）	4	订购信息	18
软件存储	4	订购代码定义	18
软件回读	5	封装图	19
阻止自动存储	6	缩略语	20
数据保护	6	文档规范	20
最大额定值	7	测量单位	20
工作范围	7	文档修订记录页	21
直流电气特性	7	销售、解决方案和法律信息	22
数据保留时间和耐久性	8	全球销售和 design 支持	22
电容值	8	产品	22
热阻	8	PSoC [®] 解决方案	22
交流测试负载	9	赛普拉斯开发者社区	22
交流测试条件	9	技术支持	22
交流开关特性	10		
开关波形	11		

引脚分布

图 1. 引脚图 — 48 球星焊盘 FBGA



引脚定义

引脚名称	I/O 类型	说明
A ₀ -A ₁₈	输入	对于 × 8 配置，该地址引脚用于选择 524,288 个 nvSRAM 字节中的某一个。
A ₀ -A ₁₇		对于 × 16 配置，该地址引脚用于选择 262,144 个 nvSRAM 字中的某一个。
DQ ₀ -DQ ₇	输入 / 输出	用于 ×8 配置的双向数据 I/O 线。根据操作将该引脚作为输入或输出线路使用。
DQ ₀ -DQ ₁₅		用于 ×16 配置的双向数据 I/O 线。根据操作将该引脚作为输入或输出线路使用。
WE	输入	写使能输入，低电平有效。该引脚为低电平时，I/O 引脚上的数据被写入到指定的地址。
CE	输入	芯片使能输入，低电平有效。当该引脚为低电平时，将选择芯片。处于高电平时，则取消选择芯片。
OE	输入	输出使能，低电平有效。低电平有效 OE 输入在读周期内使能数据输出缓冲器。当 OE 为高电平时，I/O 引脚将进入三态。
BHE	输入	字节高电平使能，低电平有效。控制着 DQ ₁₅ -DQ ₈ 。
BLE	输入	字节低电平使能，低电平有效。控制着 DQ ₇ -DQ ₀ 。
V _{SS}	接地	器件的接地。必须连接至系统接地端。
V _{CC}	电源	器件内核的电源输入。
V _{CCQ}	电源	器件输入和输出的电源输入。
HSB	输入 / 输出	硬件存储繁忙 (HSB)。 输出：低电平时表示 nvSRAM 处于繁忙状态。在每次硬件和软件存储操作完成后，HSB 通过标准输出高电流在一小段时间 (t _{HHHD}) 变为高电平，然后通过内部弱上拉电阻一直保持高电平（外部上拉电阻连接可选）。 输入：通过在外部将该引脚置于低电平，可执行硬件存储。
V _{CAP}	电源	自动存储电容器。在断电期间为 nvSRAM 提供电源，以在该过程中将数据从 SRAM 存储到非易失性元件。
NC	无连接	无连接。该引脚未与芯片连接。

注释：

4. 8 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。

器件运行

CY14V104LA/CY14V104NA nvSRAM 由物理相同单元中的两个功能组件成对组成。它们是一个 SRAM 存储器单元和一个非易失性 QuantumTrap 单元。SRAM 存储器单元可作为标准的快速静态 RAM 工作。SRAM 中的数据被传输到非易失性单元（存储操作），或从非易失性单元传输到 SRAM（回读操作）。使用该独特的架构，所有单元都可以并行执行存储和回读操作。在存储和回读操作期间，SRAM 读写操作被禁止。与 SRAM 相同，CY14V104LA/CY14V104NA 支持无限次读写操作。此外，它还提供了无限次数的从非易失性单元的回读操作以及最多达 100 万次的存储操作。请参考第 17 页上的 [SRAM 操作的真值表](#)，以便获得读写模式的完整说明。

SRAM 读取

当 \overline{CE} 和 \overline{OE} 为低电平，且 \overline{WE} 和 \overline{HSB} 为高电平时，CY14V104LA/CY14V104NA 将执行读周期。引脚 A_{0-18} 或 A_{0-17} 上指定的地址将确定要访问 524,288 个数据字节中或者 262,144 个字（每个字 16 位）中的哪一个。字节使能（ \overline{BHE} 、 \overline{BLE} ）确定将哪些字节使能为输出（在 16 位字的情况下）。当读取由地址转换触发时，输出在经过 t_{AA} （读取周期 1）时间后有效。如果 \overline{CE} 或 \overline{OE} 启动了读取操作，输出会在 t_{ACE} 或 t_{DOE} 中较晚者时有效（读取周期 2）。数据输出在 t_{AA} 访问时间内反复响应地址变化而不需要切换任何控制输入引脚。这一一直有效，直到另一个地址变化或直到 \overline{CE} 或 \overline{OE} 变为高电平，或 \overline{WE} 或 \overline{HSB} 变为低电平为止。

SRAM 写入

当 \overline{CE} 和 \overline{WE} 均为低电平且 \overline{HSB} 为高电平时，将执行写循环。地址输入必须稳定才能进入写周期，并且必须保持稳定，直到 \overline{CE} 或 \overline{WE} 在周期结束时变为高电平为止。如果数据在 \overline{WE} 控制的写入结束前或在 \overline{CE} 控制的写入结束前的 t_{SD} 时长有效，则公用 I/O 引脚 DQ_{0-15} 上的数据被写入到存储器中。字节使能输入（ \overline{BHE} 、 \overline{BLE} ）确定在 16 位字的情况下写入哪些字节。推荐在整个写周期内保持 \overline{OE} 为高电平，以避免公用 I/O 线路上出现数据总线争用情况。如果 \overline{OE} 为低电平，那么在 \overline{WE} 变为低电平之后，内部电路将在 t_{HZWE} 时间内关闭输出缓冲器。

自动存储操作

CY14V104LA/CY14V104NA 通过下面三个方法之一将数据存储在 nvSRAM 内：由 \overline{HSB} 激活的硬件存储操作；由地址序列激活的软件存储操作；器件断电时的自动存储。自动存储操作是 QuantumTrap 技术的独有特性，在 CY14V104LA/CY14V104NA 上默认使能该特性。

在正常工作时，器件从 V_{CC} 接收电流，进而给与 V_{CAP} 引脚连接的电容器充电。芯片使用该存储的电荷执行单个存储操作。如果 V_{CC} 引脚的电压下降到 V_{SWITCH} 以下，器件会自动将 V_{CAP} 引脚与 V_{CC} 的连接断开。通过 V_{CAP} 电容器所提供的电源触发存储操作。

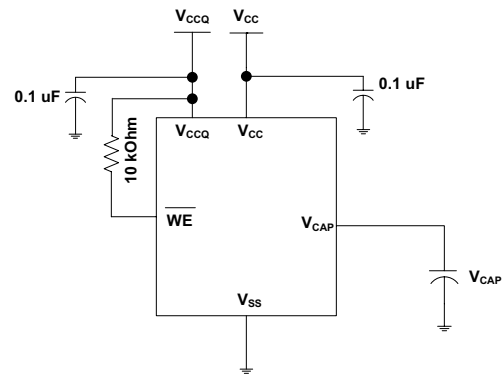
注意：如果电容器未与 V_{CAP} 引脚连接，则必须使用第 6 页上的 [阻止自动存储](#) 中指定的软件列禁用自动存储。如果在 V_{CAP} 引脚上没有连接电容器时启用了自动存储性能，则器件将在电荷不足的情况下尝试执行自动存储操作以完成存储。这样可破坏 nvSRAM 中存储的数据。

图 2 显示的是自动存储操作的存储电容器（ V_{CAP} ）的合适连接。请参考第 7 页上的 [直流电气特性](#)，以便了解 V_{CAP} 的大小。 V_{CAP} 引脚上的电压通过芯片上的调压器被输入到 V_{CC} 。上拉应该置于 \overline{WE} 上，以在加电期间保持其处于非活动状态。仅当 \overline{WE} 信号在加电期间为三态时，该上拉才有效。很多 MPU 在加电时使其控制引脚进入三态。使用上拉时应验证该情况。当 nvSRAM 退出加

电回读时，MPU 必须处于活动状态或者 \overline{WE} 保持为非活动状态，直到 MPU 退出复位状态为止。

为了减少不必要的非易失性存储，将忽略自动存储和硬件存储操作，除非在最新的存储或回读周期后至少要执行一次写操作。无论是否发生写操作，都会执行软件触发的存储周期。

图 2. 自动存储模式



硬件存储操作

CY14V104LA/CY14V104NA 提供了 \overline{HSB} 引脚以控制和确定存储操作。使用 \overline{HSB} 引脚请求硬件存储周期。当 \overline{HSB} 引脚被设置为低电平时，CY14V104LA/CY14V104NA 将在 t_{DELAY} 的时间后按条件启动存储操作。仅在最后一个存储或回读周期后发生了对 SRAM 的写操作时才开始实际的存储周期。 \overline{HSB} 引脚还起到开漏驱动器（内部 100 kΩ 弱上拉电阻）的作用，它在存储进行（通过任何手段触发的）时在内部变为低电平以指示繁忙状态。

注意：在每次进行硬件和软件存储操作后， \overline{HSB} 会在一小段时间（ t_{HHHD} ）通过标准输出高电流变为高电平，然后通过内部 100 kΩ 上拉电阻一直保持高电平。

在 \overline{HSB} 通过任何手段变为低电平时进行的 SRAM 写操作要在启动存储操作之前给定的时间（ t_{DELAY} ）内完成。但是，在 \overline{HSB} 变为低电平后请求的任何 SRAM 写周期都被禁止，直到 \overline{HSB} 变回高电平为止。如果未设置写锁存，则 \overline{HSB} 不会被 CY14V104LA/CY14V104NA 置为低电平。但是所有 SRAM 读和写周期都被禁止，直到 MPU 或其他外部源使 \overline{HSB} 变回高电平为止。

在任何存储操作期间，无论它如何启动，CY14V104LA/CY14V104NA 都会继续将 \overline{HSB} 引脚设置为低电平，仅在存储完成时才会释放。完成存储操作后，CY14V104LA/CY14V104NA 保持禁用状态，直到 \overline{HSB} 引脚返回到高电平为止。如果不使用 \overline{HSB} ，请保持它的未连接状态。

硬件回读（加电）

加电时或任何低功率状态之后（ $V_{CC} < V_{SWITCH}$ ），内部回读请求将被锁存。如果 V_{CC} 再次超过了 V_{SWITCH} 的检测电压，将自动启动回读周期并需要经过 $t_{HRECALL}$ 的时长来完成。在此期间内， \overline{HSB} 驱动器将 \overline{HSB} 置为低电平。

软件存储

通过软件地址序列将数据从 SRAM 传输到非易失性存储器内。通过以准确的顺序在六个特定地址执行连续的 \overline{CE} 控制的读周期，可以启动 CY14V104LA/CY14V104NA 软件存储周期。在存储周期期间，首先擦除上一个非易失性数据，接下来执行非易失性元件程序。启动存储周期后，将禁用后续的输入和输出，直到该周期完成。

由于特定地址的读取序列用于存储启动，所以在该序列中要避免其他读或写访问干预，否则该序列会被终止并且不会发生任何存储或回读操作。

想要启动软件存储周期，必须执行下列读取序列。

1. 读取地址 0x4E38 有效读取
2. 读取地址 0xB1C7 有效读取
3. 读取地址 0x83E0 有效读取
4. 读取地址 0x7C1F 有效读取
5. 读取地址 0x703F 有效读取
6. 读取地址 0x8FC0，启动存储周期

当 \overline{WE} 在六个读取序列中始终保持高电平状态时，可以通过 \overline{CE} 控制的读取或 \overline{OE} 控制的读取给软件序列提供时钟脉冲。在序列中输入第六个地址之后，存储周期将立即开始，芯片被禁用。HSB 被置为低电平。达到 t_{STORE} 周期时间后，SRAM 再次被激活以进行读和写操作。

软件回读

通过软件地址序列将数据从非易失性存储器内传输到 SRAM。同启动软件存储操作相似，当想要启动软件回读周期时，也会以相同的方式执行一个读序列。若要启动回读循环，必须执行下列 \overline{CE} 控制的读操作序列。

1. 读取地址 0x4E38 有效读取
2. 读取地址 0xB1C7 有效读取
3. 读取地址 0x83E0 有效读取
4. 读取地址 0x7C1F 有效读取
5. 读取地址 0x703F 有效读取
6. 读取地址 0x4C63，启动回读周期

在内部，回读是两步程序。首先，SRAM 数据被清除；然后，非易失性信息被传输到 SRAM 单元内。在 t_{RECALL} 周期时间后，SRAM 再次处于就绪状态，以进行读和写操作。回读操作并不会更改非易失性元件中的数据。

表 1. 模式选择

\overline{CE}	\overline{WE}	\overline{OE}	\overline{BHE} 、 \overline{BLE} ^[5]	$A_{15}-A_0$ ^[6]	模式	I/O	电源
H	X	X	X	X	未选中	输出高阻态	待机
L	H	L	L	X	读取 SRAM	输出数据	活动
L	L	X	L	X	写入 SRAM	输入数据	活动
L	H	L	X	0x4E38 0xB1C7 0x83E0 0x7C1F 0x703F 0x8B45	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 自动存储禁用	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据	激活 ^[7]

注释：

5. \overline{BHE} 和 \overline{BLE} 仅适用于 $\times 16$ 配置。
6. CY14V104LA 上有 19 个地址行（CY14V104NA 上有 18 个地址行），只有 13 个地址行（ $A_{14}-A_2$ ）用于控制软件模式。无需关注余下的地址行。
7. 六个连续的地址必须按顺序列出。 \overline{WE} 在六个周期期间必须保持为高电平才能使非易失性循环。

表 1. 模式选择 (续)

\overline{CE}	\overline{WE}	\overline{OE}	\overline{BHE} 、 \overline{BLE} ^[5]	$A_{15}-A_0$ ^[6]	模式	I/O	电源
L	H	L	X	0x4E38 0xB1C7 0x83E0 0x7C1F 0x703F 0x4B46	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 自动存储使能	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据	激活 ^[8]
L	H	L	X	0x4E38 0xB1C7 0x83E0 0x7C1F 0x703F 0x8FC0	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 非易失性存储	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出高阻态	活动 I_{CC2} ^[8]
L	H	L	X	0x4E38 0xB1C7 0x83E0 0x7C1F 0x703F 0x4C63	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 非易失性回读	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出高阻态	激活 ^[8]

阻止自动存储

通过启动自动存储禁用的序列，可以禁用自动存储功能。同启动软件存储操作相似，想要启动自动存储时，要以同样的方式执行读序列。如要启动自动存储禁用序列，必须执行下列 \overline{CE} 控制的读操作序列：

1. 读取地址 0x4E38 有效读取
2. 读取地址 0xB1C7 有效读取
3. 读取地址 0x83E0 有效读取
4. 读取地址 0x7C1F 有效读取
5. 读取地址 0x703F 有效读取
6. 读取地址 0x8B45 自动存储禁用

通过启动自动存储使能序列，可以重新使能自动存储。使用与启动软件回读相似的方式执行读操作序列。如果要启动自动存储使能序列，必须执行下列 \overline{CE} 控制的读操作序列：

1. 读取地址 0x4E38 有效读取
2. 读取地址 0xB1C7 有效读取
3. 读取地址 0x83E0 有效读取
4. 读取地址 0x7C1F 有效读取
5. 读取地址 0x703F 有效读取
6. 读取地址 0x4B46 自动存储使能

如果禁用或重新使能自动存储功能，则必须触发手动存储操作（软件或硬件）才能在后续的断电循环中保存自动存储的状态。器件出厂时已使能自动存储功能，且已在所有单元中写入了 0x00。

数据保护

CY14V104LA/CY14V104NA 通过禁止外部启动的存储和写操作，在低电压状态下阻止数据的破坏。当 $V_{CC} < V_{SWITCH}$ 时，会检测到低电压状态。如果 CY14V104LA/CY14V104NA 在加电时处于写模式（ \overline{CE} 和 \overline{WE} 均为低电平），在回读或存储后将禁止写操作，直到 t_{LZHSB} （HSB 到输出有效的时间）后 SRAM 被使能为止。当 $V_{CCQ} < V_{IOPIS}$ 时，各 I/O 将被禁用（无存储指令）。这样可防止在 V_{CCQ} 加电期间内掉电条件下发生意外地写操作。

注释：

8. 六个连续的地址必须按顺序列出。 \overline{WE} 在六个周期期间必须保持为高电平才能使能非易失性循环。

最大额定值

超过最大额定值可能会影响器件的使用寿命。这些用户指导未经过测试。

存放温度	-65 °C 到 +150 °C
最长存储时间	
在 150°C 环境温度下	1000 个小时
在 85°C 环境温度下	20 年
最高结温	150°C
V _{CC} 上相对于 V _{SS} 的供电电压	-0.5 V 到 4.1 V
V _{CCQ} 上相对于 V _{SS} 的供电电压	-0.5 V 到 2.45 V
应用于高阻态的输出电压	-0.5 V 到 V _{CCQ} + 0.5 V
输入电压	-0.5 V 到 V _{CCQ} + 0.5 V

在接地电位的所有引脚上的瞬变电压 (< 20 ns)	-2.0 V 到 V _{CCQ} + 2.0 V
封装功率散耗能力 (T _A = 25 °C)	1.0 W
表面贴装铅焊温度 (3 秒)	+260 °C
直流输出电流	
(每次只输出 1 路电流, 持续时间为 1 秒)	15 mA
静电放电电压	
(根据 MIL-STD-883, 方法 3015)	> 2001 V
栓锁电流	> 140 mA

工作范围

范围	环境温度	V _{CC}	V _{CCQ}
工业级	-40°C 至 +85°C	3.0 V 至 3.6 V	1.65 V 至 1.95 V

直流电气特性

在工作范围内

参数	说明	测试条件	最小值	典型值 ^[9]	最大值	单位
V _{CC}	供电电压	-	3.0	3.3	3.6	V
V _{CCQ}			1.65	1.8	1.95	V
I _{CC1}	V _{CC} 平均电流	t _{RC} = 25 ns t _{RC} = 45 ns	-	-	70	mA
I _{CCQ1}	V _{CCQ} 平均电流	无输出负载下取得的值 (I _{OUT} = 0 mA)	-	-	52	mA
I _{CC2}	存储过程中的 V _{CC} 平均电流	所有输入无需关注, V _{CC} = t _{STORE} 持续时间内的最大平均电流	-	-	15	mA
I _{CC3}	在 t _{RC} = 200 ns, V _{CC(Typ)} , 25 °C 条件下的 V _{CC} 平均电流	所有输入在 CMOS 电平循环。无输出负载下取得的值 (I _{OUT} = 0 mA)。	-	35	10	mA
I _{CCQ3}	在 t _{RC} = 200 ns, V _{CCQ(Typ)} , 25 °C 条件下的 V _{CCQ} 平均电流		-	5	8	mA
I _{CC4}	自动存储周期期间的 V _{CAP} 平均电流	无需关注所有输入。t _{STORE} 期间的平均电流	-	-	8	mA
I _{SB}	V _{CC} 待机电流	CE ≥ (V _{CCQ} - 0.2 V)。V _{IN} ≤ 0.2 V 或 ≥ (V _{CC} - 0.2 V)。非易失性周期完成后的待机电流电平。输入为静态。f = 0 MHz。	-	-	8	mA
I _{IX} ^[10]	输入漏电流 (HSB 除外)	V _{CCQ} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{IN} ≤ V _{CCQ}	-1	-	+1	μA
	输入漏电流 (供给 HSB)	V _{CCQ} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{IN} ≤ V _{CCQ}	-100	-	+1	μA
I _{OZ}	断开状态输出漏电流	V _{CCQ} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{OUT} ≤ V _{CCQ} , CE 或 OE ≥ V _{IH} 或 BHE/BLE ≥ V _{IH} 或 WE ≤ V _{IL}	-1	-	+1	μA
V _{CAP} ^[11]	存储电容器	在 V _{CAP} 引脚和 V _{SS} 之间	61	68	180	μF
V _{VCAP} ^[9, 12]	器件在 V _{CAP} 引脚上的最大驱动电压	V _{CC} = 最大值	-	-	V _{CC}	V

注释:

- 典型值的温度为 25 °C, V_{CC} = V_{CC(Typ)} 和 V_{CCQ} = V_{CCQ(Typ)}。并未经过 100% 测试。
- 如果高电平和低电平有效的驱动程序均被禁用, 对于 HSB 引脚, 当 V_{OH} 等于 1.07 V 时, I_{OUT} = -4 μA。使能这些驱动程序后, 标准 V_{OH} 和 V_{OL} 均有效。该参数被特性表征化, 并未经过测试。
- V_{CAP} 的最小值可以保证能够提供用来完成自动存储操作的电荷。在加电回读周期内, V_{CAP} 的最大值可以确保使用最小的电压给 V_{CAP} 上的电容器充电。这样, 在紧急断电期间, 可以顺利完成自动存储操作。因此, 建议始终使用在指定最小和最大极限值内的电容器。请参考应用手册 AN43593, 以便了解有关 V_{CAP} 选项的更多信息。
- 选择 V_{CAP} 电容器时, 可提供 V_{CAP} 引脚上的最大电压 (V_{VCAP}) 作为指导。在工作温度范围内, V_{CAP} 电容器的额定电压应高于 V_{VCAP} 电压。

直流电气特性 (续)

在工作范围内

参数	说明	测试条件	最小值	典型值 ^[9]	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压	–	0.7 × V _{CCQ}	–	V _{CCQ} + 0.3	V
V _{IL}	输入低电平电压	–	– 0.3	–	0.3 × V _{CCQ}	V
V _{OH}	输出高电压	I _{OUT} = –1 mA	V _{CCQ} – 0.45	–	–	V
V _{OL}	输出低电压	I _{OUT} = 2 mA	–	–	0.45	V

数据保留时间和耐久性

在工作范围内

参数	说明	最小值	单位
DATA _R	数据保留时间	20	年
NV _C	非易失性存储操作	1,000	K

电容值

参数 ^[13]	说明	测试条件	最大值	单位
C _{IN}	输入电容 (BLE、BHE 和 HSB 除外)	T _A = 25 °C, f = 1 MHz, V _{CC} = V _{CC} (Typ), V _{CCQ} = V _{CCQ} (Typ)	7	pF
	输入电容 (供给 BLE、BHE 和 HSB)		8	pF
C _{OUT}	输出电容 (HSB 除外)		7	pF
	输出电容 (供给 HSB)		8	pF

热阻

下表列出了各种热电阻参数。

参数 ^[13]	说明	测试条件	48 球形焊盘 FBGA	单位
θ _{JA}	热阻 (结温到室温)	根据 EIA/JESD51 的要求, 测试条件遵循了测试热阻的标准测试方法和过程。	46.09	°C/W
θ _{JC}	热电阻 (结温至壳温)		7.84	°C/W

注释:

13. 这些参数仅通过设计保证, 并未经过测试。

交流测试负载

图 3. 交流测试负载



交流测试条件

输入脉冲电平 0 V 到 1.8 V
 输入上升和下降时间 (10% – 90%) ≤ 1.8 ns
 输入和输出的时序参考电平 0.9 V

交流开关特性

在工作范围内

参数 ^[14]		说明	25 ns		45 ns		单位
赛普拉斯参数	备用参数		最小值	最大值	最小值	最大值	
SRAM 读周期							
t _{ACE}	t _{ACS}	芯片使能访问时间	–	25	–	45	ns
t _{RC} ^[15]	t _{RC}	读周期的时间	25	–	45	–	ns
t _{AA} ^[16]	t _{AA}	地址访问时间	–	25	–	45	ns
t _{DOE}	t _{OE}	输出使能到数据有效的时间	–	12	–	20	ns
t _{OHA} ^[16]	t _{OH}	地址更改后输出保持的时间	3	–	3	–	ns
t _{LZCE} ^[17, 18]	t _{LZ}	芯片使能到输出有效的时间	3	–	3	–	ns
t _{HZCE} ^[17, 18]	t _{HZ}	芯片禁用到输出无效的时间	–	10	–	15	ns
t _{LZOE} ^[17, 18]	t _{OLZ}	输出使能到输出有效的时间	0	–	0	–	ns
t _{HZOE} ^[17, 18]	t _{OHz}	输出禁用到输出无效的时间	–	10	–	15	ns
t _{PU} ^[17]	t _{PA}	芯片使能到电源有效的时间	0	–	0	–	ns
t _{PD} ^[17]	t _{PS}	芯片禁用到电源待机的时间	–	25	–	45	ns
t _{DBE}	–	字节使能到数据有效的时间	–	12	–	20	ns
t _{LZBE} ^[17]	–	字节使能到输出有效的时间	0	–	0	–	ns
t _{HZBE} ^[17]	–	字节禁用到输出无效的时间	–	10	–	15	ns
SRAM 写周期							
t _{WC}	t _{WC}	写周期时间	25	–	45	–	ns
t _{PWE}	t _{WP}	写入脉冲宽度	20	–	30	–	ns
t _{SCE}	t _{CW}	芯片使能到写周期结束的时间	20	–	30	–	ns
t _{SD}	t _{DW}	数据建立到写周期结束的时间	10	–	15	–	ns
t _{HD}	t _{DH}	写周期结束后数据保持的时间	0	–	0	–	ns
t _{AW}	t _{AW}	地址建立到写周期结束的时间	20	–	30	–	ns
t _{SA}	t _{AS}	地址建立到写周期开始的时间	0	–	0	–	ns
t _{HA}	t _{WR}	写周期结束后地址保持的时间	0	–	0	–	ns
t _{HZWE} ^[17, 18, 19]	t _{WZ}	写周期使能到输出禁用的时间	–	10	–	15	ns
t _{LZWE} ^[17, 18]	t _{OW}	写周期结束后输出有效的时间	3	–	3	–	ns
t _{BW}	–	字节使能到写周期结束的时间	20	–	30	–	ns

注释:

- 测试条件采用等于或小于 1.8 ns 的信号跃迁时间, V_{CCQ}/2 的时序参考电平, 0 至 V_{CCQ(tp)} 的输入脉冲电平, 以及第 9 页上的图 3 中所示的指定 I_{OL}/I_{OH} 的输出负载和负载电容。
- WE 必须在 SRAM 读周期内保持为高电平状态。
- 当 CE、OE 和 BHE/BLE 均处于低电平状态时, 器件将继续被选中。
- 这些参数仅通过设计保证, 并未经过测试。
- 测量条件是在稳定状态下输出电压的 ±200 mV 范围内。
- 如果 CE 变为低电平时 WE 也处于低电平状态, 则输出会保持高阻抗状态。
- HSB 必须在读和写周期内保持为高电平状态。

开关波形

图 4. SRAM 读周期 #1 (地址控制) [21、22、23]

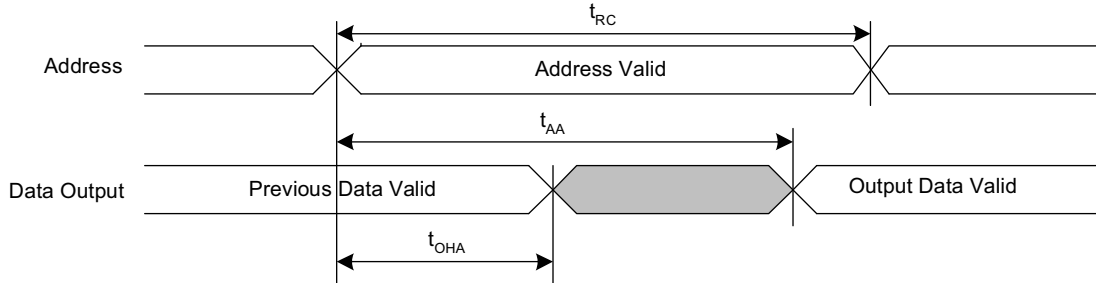
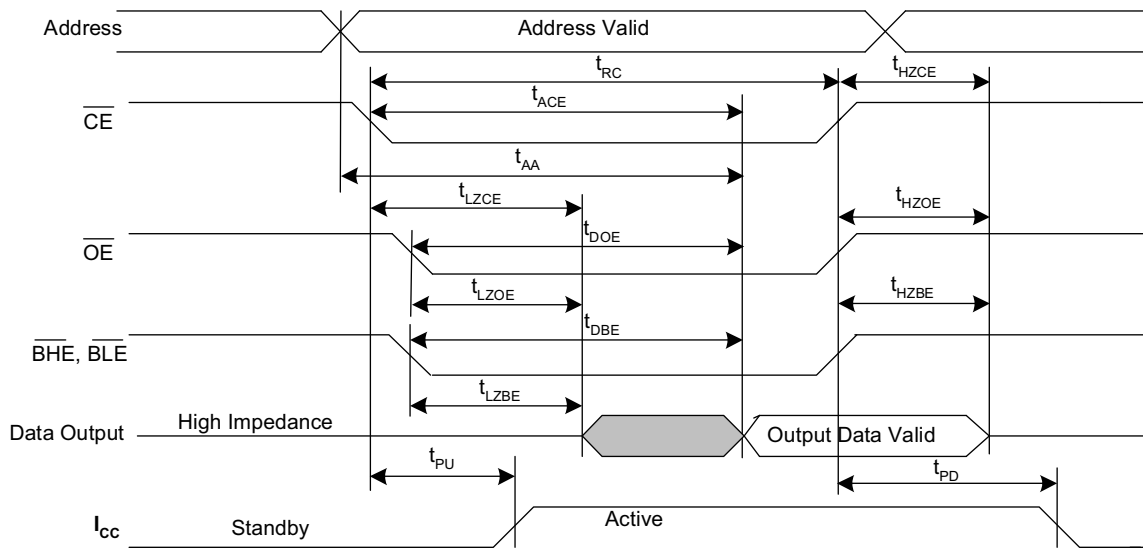


图 5. SRAM 读周期 #2 (\overline{CE} 和 \overline{OE} 控制) [21、23、24]



注释:

21. \overline{WE} 必须在 SRAM 读周期内保持为高电平状态。
22. 当 \overline{CE} 、 \overline{OE} 和 BHE/ BLE 均处于低电平状态时，器件将继续被选中。
23. HSB 必须在读和写周期内保持为高电平状态。
24. 典型值的温度为 25 °C、 $V_{CC} = V_{CC(Typ)}$ 和 $V_{CCQ} = V_{CCQ(Typ)}$ 。并未经过 100% 测试。

开关波形 (续)

图 6. SRAM 写周期 #1 (\overline{WE} 控制) [25、26、27、28]

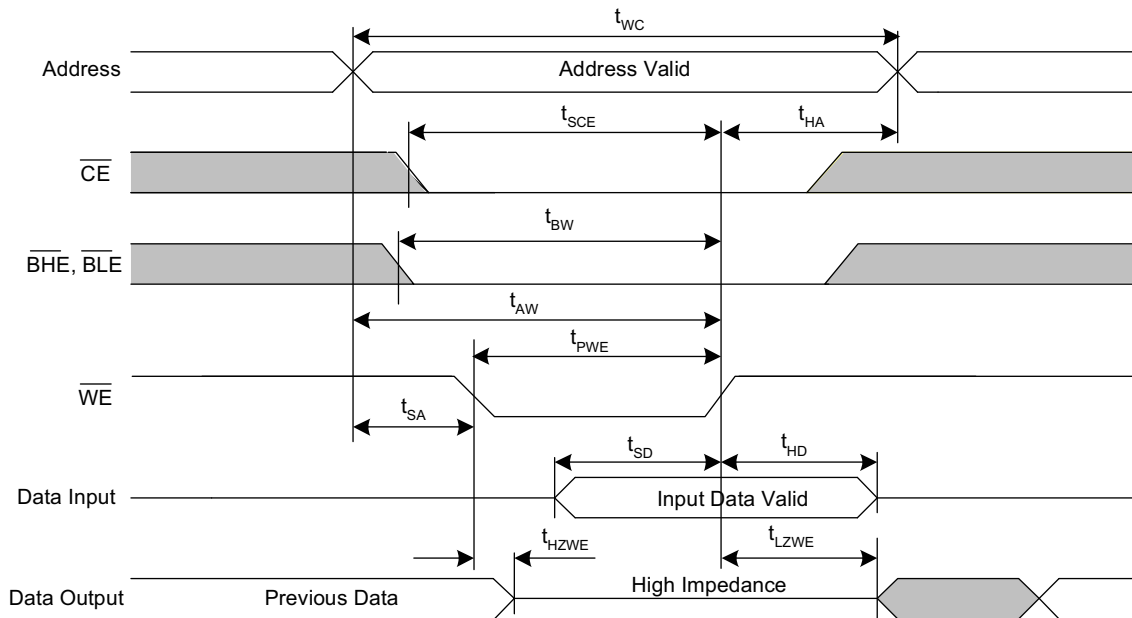
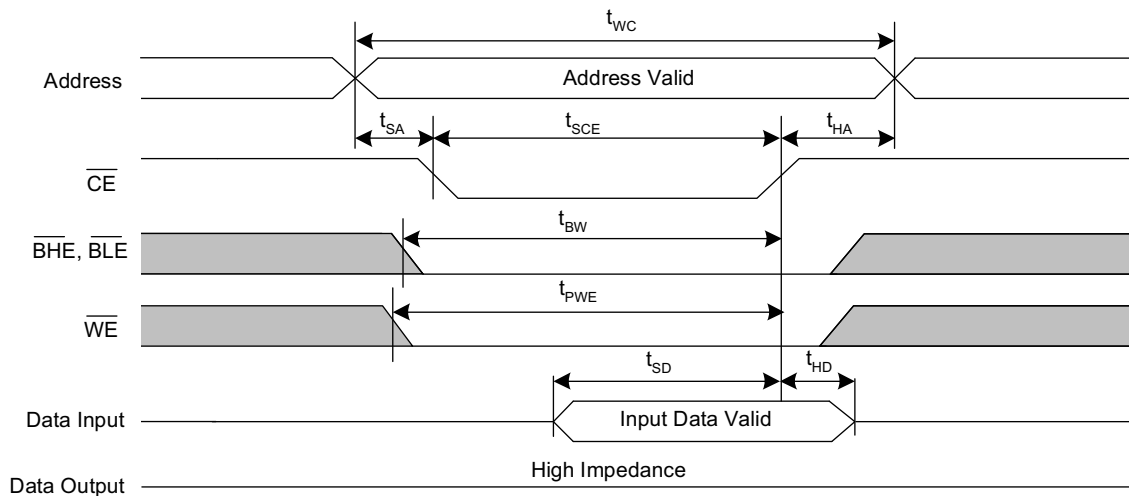


图 7. SRAM 写周期 #2 (\overline{CE} 控制) [25、26、27、28]

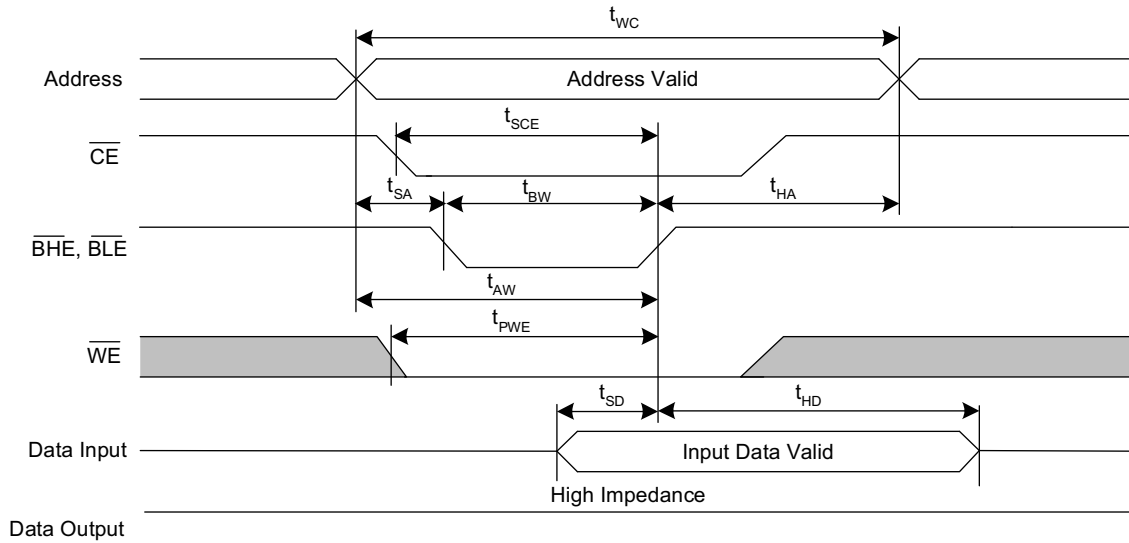


注释:

- 25. \overline{HSB} 必须在读和写周期内保持高电平状态。
- 26. \overline{BHE} 和 \overline{BLE} 仅适用于 x16 配置。
- 27. 如果 \overline{CE} 变为低电平时 \overline{WE} 处于低电平状态, 输出会保持在高阻抗状态。
- 28. 地址转换期间, \overline{CE} 或 \overline{WE} 必须 $\geq V_{IH}$ 。

开关波形 (续)

图 8. SRAM 写周期 #3 ($\overline{\text{BHE}}$ 和 $\overline{\text{BLE}}$ 控制) [29、30、31、32]



注释:

- 29. $\overline{\text{HSB}}$ 必须在读和写周期内保持为高电平状态。
- 30. $\overline{\text{BHE}}$ 和 $\overline{\text{BLE}}$ 仅适用于 $\times 16$ 配置。
- 31. 如果 $\overline{\text{CE}}$ 变为低电平时 $\overline{\text{WE}}$ 也处于低电平状态, 则输出会保持高阻抗状态。
- 32. 地址转换期间, $\overline{\text{CE}}$ 或 $\overline{\text{WE}}$ 必须 $\geq V_{IH}$ 。

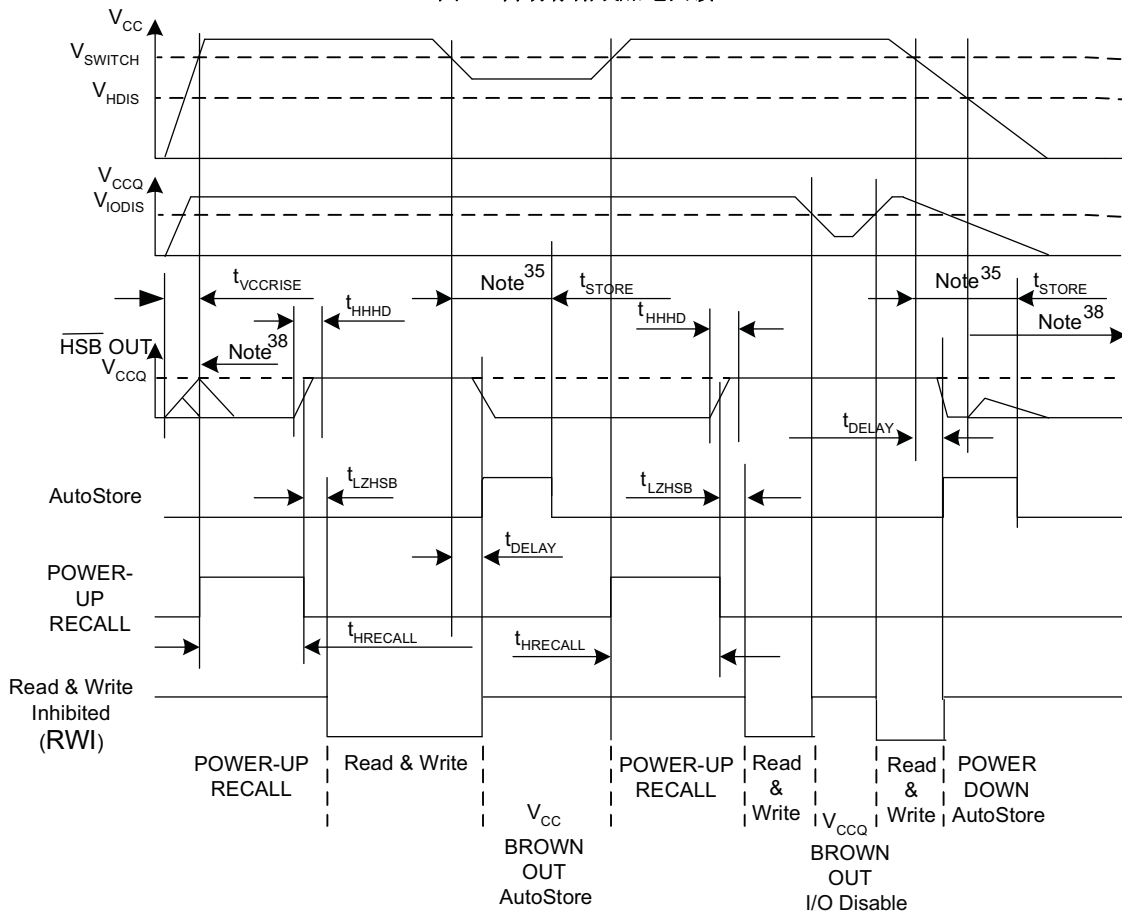
自动存储 / 加电回读

在工作范围内

参数	说明	CY14V104LA/CY14V104NA		单位
		最小值	最大值	
$t_{HRECALL}^{[33]}$	加电回读时间	-	20	ms
$t_{STORE}^{[34]}$	存储周期时间	-	8	ms
$t_{DELAY}^{[35]}$	完成 SRAM 写入周期所允许的时间	-	25	ns
V_{SWITCH}	V_{CC} 的低电压触发电平	-	2.90	V
$V_{IODIS}^{[36]}$	V_{CCQ} 的 I/O 禁用电压	-	1.50	V
$t_{VCCRRISE}^{[39]}$	V_{CC} 上升时间	150	-	μ s
$V_{HDIS}^{[39]}$	V_{CC} 的 HSB 输出禁用电压	-	1.9	V
$t_{LZHSB}^{[39]}$	HSB 到输出有效的时间	-	5	μ s
$t_{HHHD}^{[39]}$	HSB 高电平有效时间	-	500	ns

开关波形

图 9. 自动存储或加电回读^[37]



注释:

- 33. 当 V_{CC} 超过 V_{SWITCH} 时, 将开始计算 $t_{HRECALL}$ 。
- 34. 如果最后一次非易失性循环完成后尚未对 SRAM 进行写操作, 则将不会发生自动存储或硬件存储操作。
- 35. 在启动硬件存储和自动存储时, SRAM 写操作会在 t_{DELAY} 时间内持续使能。
- 36. 当电压低于 V_{IODIS} 时, HSB 不会被定义。
- 37. 如果 V_{CC} 小于 V_{SWITCH} , 那么将在存储、回读过程中忽略读写周期。
- 38. 在加电和断电期间, 在通过外部电阻上拉 HSB 引脚时, HSB 将发生短时脉冲。
- 39. 这些参数仅通过设计保证, 并未经过测试。

软件控制的存储 / 回读周期

在工作范围内

参数 [40、41]	说明	25 ns		45 ns		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{RC}	存储 / 回读初始化周期的时间	25	–	45	–	ns
t_{SA}	地址建立时间	0	–	0	–	ns
t_{CW}	时钟脉冲宽度	20	–	30	–	ns
t_{HA}	地址保持时间	0	–	0	–	ns
t_{RECALL}	回读持续时间	–	200	–	200	μ s

开关波形

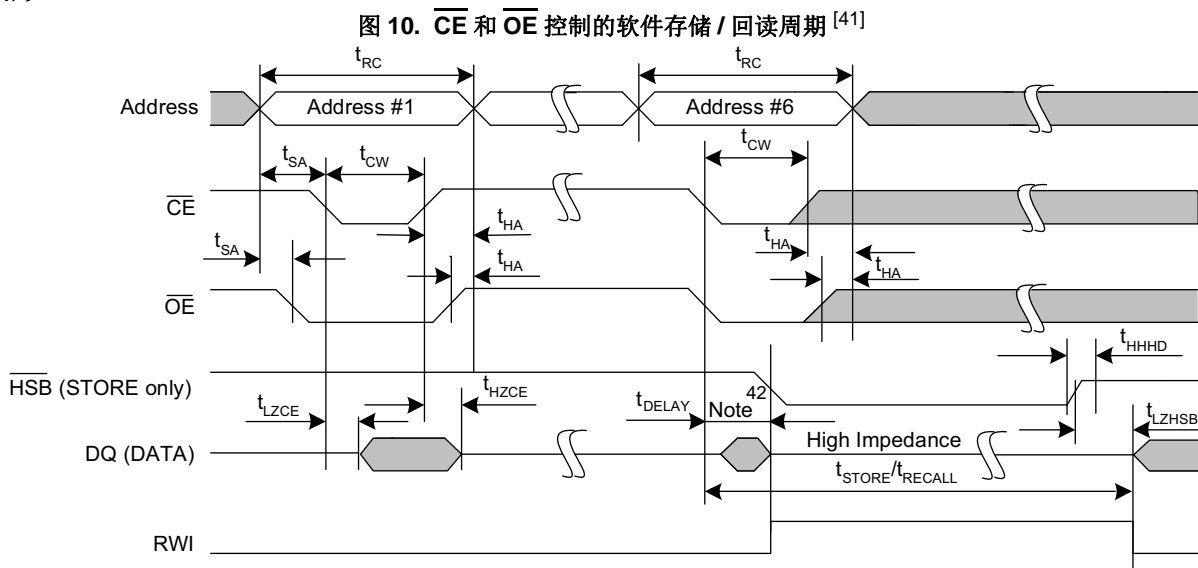
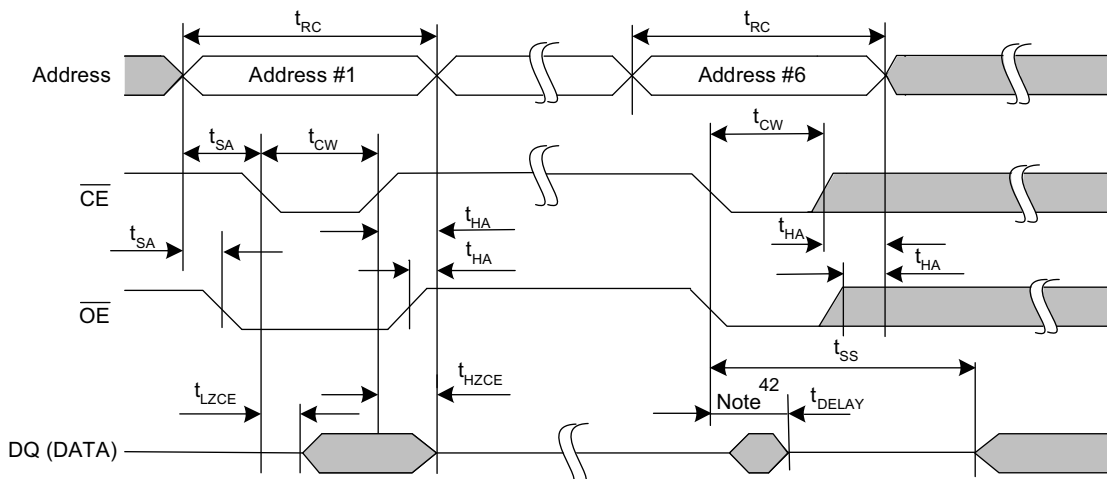


图 11. 自动存储启用 / 禁用循环



注释:

40. 由 \overline{CE} 控制的或 \overline{OE} 控制的读操作作为软件序列提供时钟脉冲。

41. 必须按第 5 页上的表 1 列出的顺序读取六个连续地址。在六个连续周期内， \overline{WE} 必须保持为高电平状态。

42. 由于在 t_{DELAY} 时间内禁用输出，第六次读取的 DQ 输出数据可能无效。

硬件存储周期

在工作范围内

参数	说明	CY14V104LA/CY14V104NA		单位
		最小值	最大值	
t_{DHSB}	未设置写入锁存时 \overline{HSB} 到输出有效的时间	-	25	ns
t_{PHSB}	硬件存储脉冲宽度	15	-	ns
t_{SS} [43、44]	软序列处理时间	-	100	μ s

开关波形

图 12. 硬件存储周期 [45]

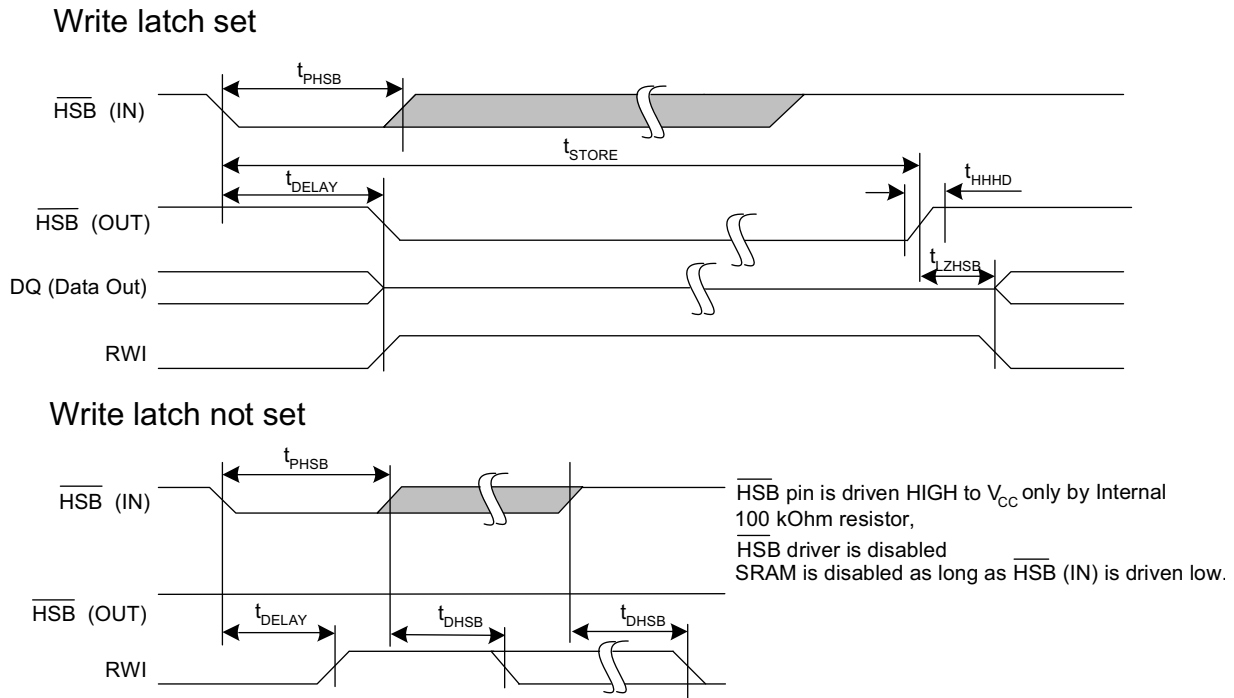
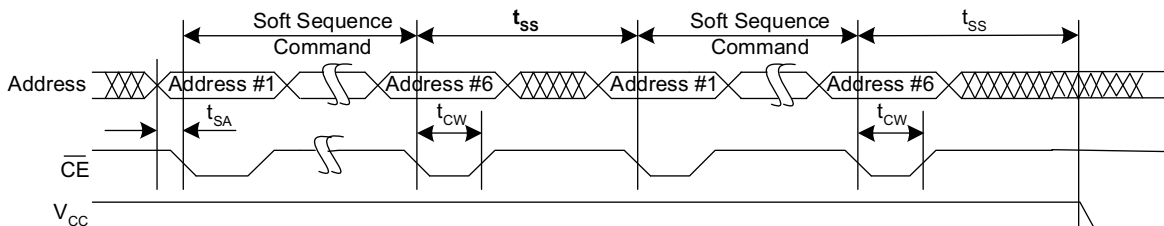


图 13. 软序列处理时间 [43、44]



注释:

- 43. 这是执行软序列指令所耗费的时间。Vcc 电压必须保持为高电平以保证有效地寄存指令。
- 44. 存储和回读等指令会锁定 I/O，直到操作完成为止，这样会更加延长该时间。请参见特定的指令。
- 45. 如果最后一次非易失性循环完成后尚未对 SRAM 进行写操作，则将不会发生自动存储或硬件存储操作。

SRAM 操作的真值表

SRAM 操作过程中，必须将 $\overline{\text{HSB}}$ 保持为高电平。

表 2. $\times 8$ 配置的真值表

CE	WE	OE	输入 / 输出 ^[46]	模式	电源
H	X	X	高阻态	取消选择 / 断电	待机
L	H	L	数据输出 (DQ ₀ -DQ ₇)	读取	活动
L	H	H	高阻态	输出处于禁用状态	活动
L	L	X	数据输入 (DQ ₀ -DQ ₇)	写入	活动

表 3. $\times 16$ 配置的真值表

CE	WE	OE	BHE ^[47]	BLE ^[47]	输入 / 输出 ^[46]	模式	电源
H	X	X	X	X	高阻态	取消选择 / 断电	待机
L	X	X	H	H	高阻态	输出处于禁用状态	活动
L	H	L	L	L	数据输出 (DQ ₀ -DQ ₁₅)	读取	活动
L	H	L	H	L	数据输出 (DQ ₀ -DQ ₇) ; DQ ₈ -DQ ₁₅ (处于高阻态)	读取	活动
L	H	L	L	H	数据输出 (DQ ₈ -DQ ₁₅) ; DQ ₀ -DQ ₇ (处于高阻态)	读取	活动
L	H	H	L	L	高阻态	输出处于禁用状态	活动
L	H	H	H	L	高阻态	输出处于禁用状态	活动模式
L	H	H	L	H	高阻态	输出处于禁用状态	活动模式
L	L	X	L	L	数据输入 (DQ ₀ -DQ ₁₅)	写入	活动模式
L	L	X	H	L	数据输入 (DQ ₀ -DQ ₇) ; DQ ₈ -DQ ₁₅ (处于高阻态)	写入	活动模式
L	L	X	L	H	数据输入 (DQ ₈ -DQ ₁₅) ; DQ ₀ -DQ ₇ (处于高阻态)	写入	活动模式

注释:

46. 数据 DQ₀-DQ₇ 适用于 $\times 8$ 配置; 数据 DQ₀-DQ₁₅ 适用于 $\times 16$ 配置。

47. BHE 和 BLE 仅适用于 $\times 16$ 配置。

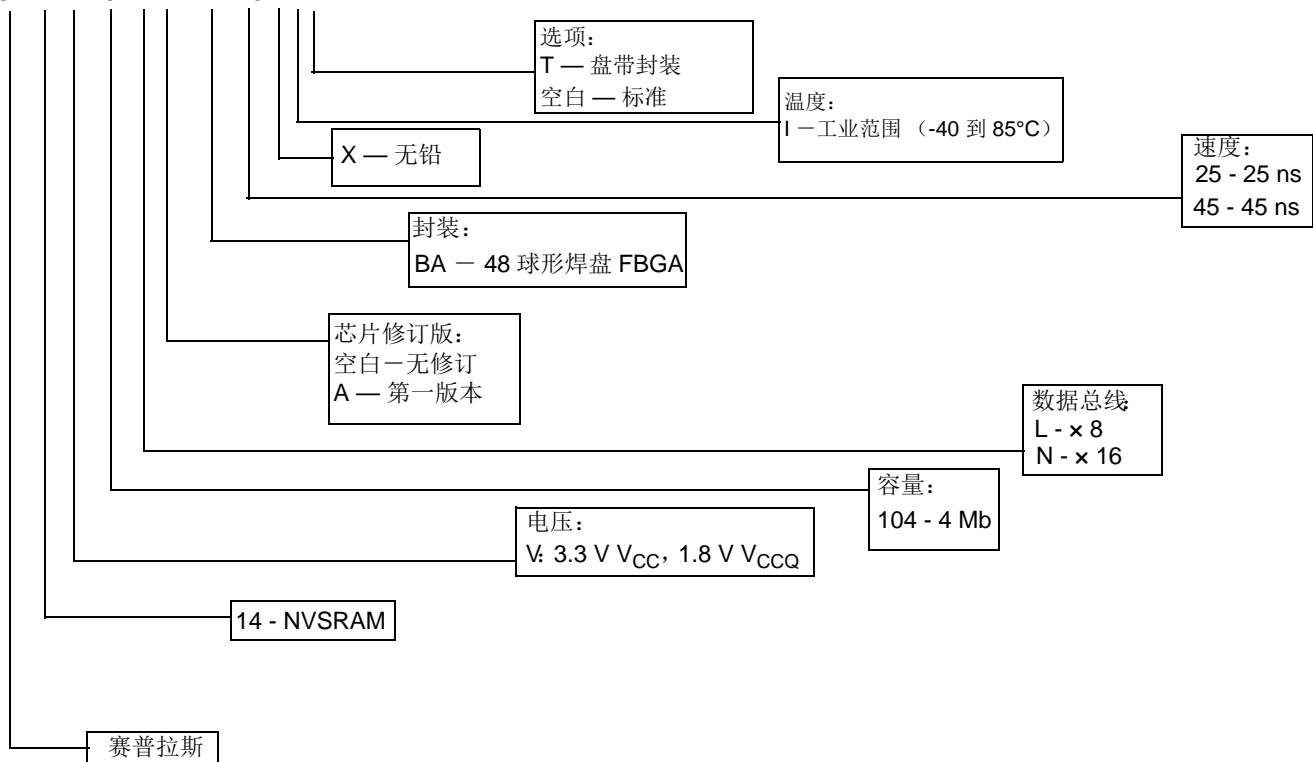
订购信息

速率 (ns)	订购代码	封装图	封装类型	工作范围
25	CY14V104LA-BA25XIT	51-85128	48 球形焊盘 FBGA	工业级
	CY14V104LA-BA25XI			
	CY14V104NA-BA25XIT			
	CY14V104NA-BA25XI			
45	CY14V104LA-BA45XIT			
	CY14V104LA-BA45XI			
	CY14V104NA-BA45XIT			
	CY14V104NA-BA45XI			

想要了解这些芯片的供应情况，请联系赛普拉斯本地销售代表。

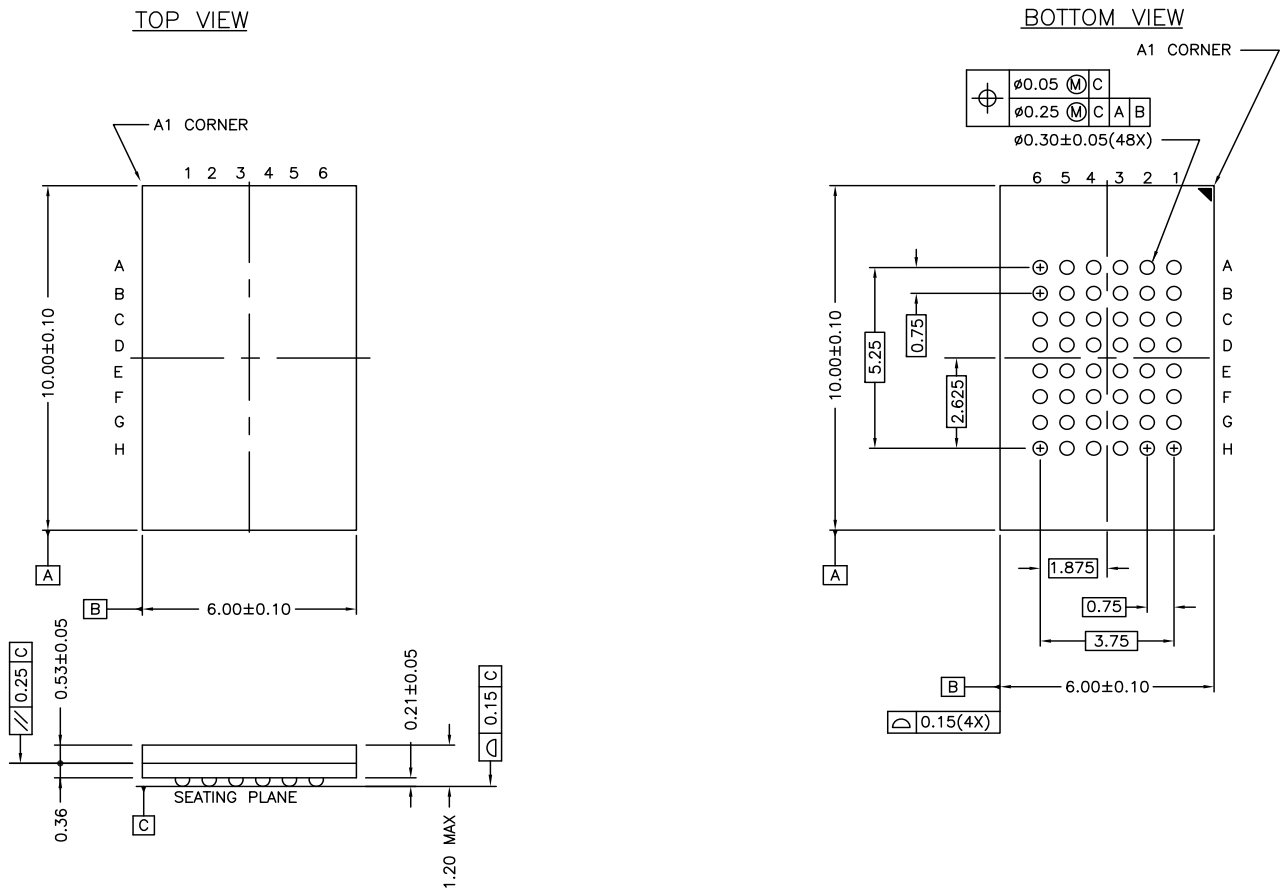
订购代码定义

CY 14 V 104 L A - BA 25 X I T



封装图

图 14. 48 球形焊盘 FBGA (6 × 10 × 1.2 mm) BA48B, 51-85128



51-85128 *G

缩略语

缩略语	说明
BHE	字节高电平使能
$\overline{\text{BLE}}$	字节低电平使能
$\overline{\text{CE}}$	芯片使能
CMOS	互补金属氧化物半导体
EIA	电子工业联盟
FBGA	小间距球栅阵列
$\overline{\text{HSB}}$	硬件存储繁忙
I/O	输入 / 输出
nvSRAM	非易失性静态随机存取存储器
OE	输出使能
RoHS	有害物质限制
SRAM	静态随机存取存储器
WE	写使能

文档规范

测量单位

符号	测量单位
°C	摄氏度
k Ω	千欧
MHz	兆赫兹
μA	微安
mA	毫安
μF	微法
μs	微秒
ms	毫秒
ns	纳秒
Ω	欧姆
%	百分比
pF	皮法
V	伏特
W	瓦特

文档修订记录页

文档标题: CY14V104LA/CY14V104NA, 4 Mbit (512 K x 8 / 256 K x 16) nvSRAM				
文档编号: 001-95816				
版本	ECN 编号	变更者	提交日期	变更说明
**	4691555	LYAO	04/23/2015	本文档版本号为 Rev**, 译自英文版 001-53954 Rev*H。